

6274 **新川**

長野 高志 (ナガノ タカシ)

株式会社新川社長

IoT 社会におけるパッケージ実装の技術革新

◆2017年3月期第2四半期決算の概要

売上高は60億46百万円（前年同期比21.1%減）となった。当期は比較的強みとするメモリ市場の設備投資が抑制され、年明けから市場が全体として停滞した結果、期中の売上高が低調に推移した。第2四半期には、スマートフォンの大容量化やサーバのSSD化を背景にNAND型フラッシュメモリの需要が急増し、メモリメーカー各社が積極的な設備投資を開始するなど市場は回復基調となった。このため市場を絞った挽回策を図り、近年では、最高の受注額を達成した。しかし累計期間での大幅な売上高増加には至らず、大幅減収という不本意な結果となった。また、8割強が海外顧客であるために、為替相場の変動が大きく影響したことから、営業損失は5億7百万円（前年同期は営業利益1億60百万円）となり、為替差損4億51百万円を営業外費用に計上した。その影響もあり経常損失は9億13百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失は9億95百万円となった。

研究開発費は前期実績14億60百万円に対し、当期通期では15億円を計画している。当第2四半期は6億92百万円となり、期初計画通りに進捗している。現在は主に既存機の操作性向上と機能向上開発、および次世代機の開発に取り組んでいる。特にハイエンド領域での新しいプロセスに対応したフリップチップボンダの開発に注力している。この業界では研究開発が生命線であり、今後も伸びる市場に研究開発費を投入していきたい。

当第2四半期の設備投資額は1億70百万円である。タイ工場量産化のための設備投資は一巡している。当期は今後のIoT社会への対応として、主に工場の検査工程の自動化や出荷データのペーパーレス化をはじめとするIT化投資に注力している。当期通期の設備投資額は3億円を計画しており、ほぼ計画通りに推移している。

機種別売上高構成比は、主力製品であるワイヤボンダが68.6%（前年同期実績74.9%）であり、依然として比率が高い。またダイボンダは10.9%（同8.7%）、フリップチップボンダは7.0%（同6.8%）を占め、次世代機の開発に注力してきた成果が徐々に表れつつある。

地域別売上高構成比は、電子部品関連企業向けを主とする日本市場が17.2%（前年同期実績15.7%）、積極的な設備投資を行う大手メモリメーカー向けを主とする韓国市場が23.7%（同25.5%）を占める。また台湾市場は、大手OSAT向けにフリップチップボンダなど次世代ハイエンド領域の装置の納入実績ができたことから6.8%（同2.3%）に伸長した。さらにタイ市場においても、同国内に工場を有する中堅OSATからの受注が増加して14.7%（同2.6%）に伸びた。この2つの市場の伸長もあり、中国市場向けの比率は32.4%（同39.4%）に低下した。

◆通期業績予想

上述のように、第2四半期連結業績は、為替相場の変動により営業損失、経常損失、親会社株主に帰属する四半期純損失が前回予想よりも大幅に増加した。このため通期連結業績は、メモリおよび車載用半導体の需要が好調に推移すると見込まれることから売上高については上方修正したが、利益面は下方修正することとなった。修正後の業績予想は、売上高173億円（前期比36.6%増）、営業利益4億10百万円、経常利益2億20百万円、親会社株主に帰属する当期純利益1億円である。

◆IoT時代に向けた取り組み

専務 永田 憲雅

近年盛んにIoTという言葉が聞かれるようになり、従来、半導体業界をけん引してきたPCやスマートフォンだけではなく、インダストリーや医療関係なども含めて、パッケージの実装方法が多様化している。こうした状況を受けて、当社は以下の2つの大きな柱の下で製品開発を進めている。1つは、システムが小型パッケージ化されていく中で、高密度モジュールやシステムインパッケージ（SiP）向けの高精度な実装の技術を実現することであり、もう1つは、IoTを駆使して、管理やメンテナンスを含めた自動化技術を実現することである。

エレクトロニクス製品の市場規模は、引き続きスマートフォンが大きな比重を占めるが、その成長率は低下しており、一方で、クラウドサーバやストレージ、ITインフラ関連など、IoT分野の成長が顕著になっている。

IoT社会に欠かせない、クラウドコンピューティングでは、三次元実装やフリップチップ実装といったハイエンドな実装技術が求められ、当社は、従来のTCB工法フリップチップボンダLFBシリーズのオプション機能を強化することに加え、後継機種 of FPB-1s NeoForce を商品化した。これに、ヤマハ発動機との提携によるYSB55wを加えた3機種を取り揃え、順次顧客評価を進めている。また、パッケージの小型・薄型・SiP化に伴い、ワイヤボンダ・ダイボンダに対しても、さらなる高度かつ複合的な実装技術が求められており、それに対する商品のアップグレードも予定している。

自動化技術の実現に向けては、Shinkawa Smart Bonding Solution というコンセプトを基に、半導体の組立工程でIoT機能を取り込んだソリューションの開発を進めている。装置のインテリジェント化（センシング機能の強化）や、ネットワークのインテリジェント化（データ収集・解析機能の強化）、プロセスのインテリジェント化（ノウハウのソフト化）を推進し、IoT社会の進展に付随する課題に対して、先んじてソリューションを提案することで、顧客満足と企業価値の向上を図っていく。

（平成28年11月8日・東京）

* 当日の説明会資料は以下のHPアドレスから見るができます。

<http://www.shinkawa.com/ir/library/presentations.html>